

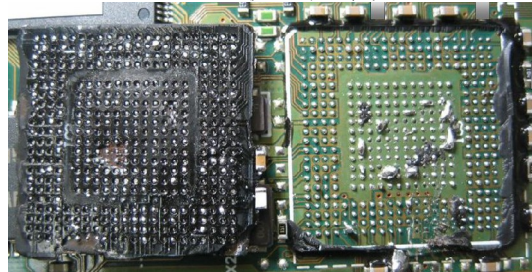
スマートフォン、カーナビ、タブレットPC 用 **BGA 取り外し装置**
アンダーフィル付き BGA の取り外しに梃子摺っていませんか？



加熱チップ



BGA 取り外し例



BGA リムーバー Model:BR-515

BR-515 はスマートフォン、カーナビやタブレット PC の基板から BGA を取り外す専用装置です。アンダーフィル剤を塗布した BGA を、20～80 秒で容易に除去します。基板の位置決めも超簡単。リワークステーションによる BGA 取り外し作業より 1/3～1/10 に短縮できます。歩留まりも飛躍的に向上します。

特 徴

- BR-515 はアンダーフィル付き BGA を 20～80 秒で基板から取り外します。
- BGA 上部から、加熱チップで直接加熱します。
- 最も強固なエポキシ系アンダーフィル剤に適応します。
- 短時間加熱で、アンダーフィル剤がキュアする前に BGA 共々基板から除去します。
- BGA のみ直接加熱するので、隣接部品を加熱しません。(基板下部ヒーター不要。)
- 基板の位置決めは超簡単！
 - ① 基板をワークホルダーにセット。
 - ② 加熱チップの下へ BGA を目視で合わせる。
 - ③ ロック。(ワークホルダーを電磁固定)
- 3ch 温度プロファイルチェッカーを内蔵、最適な加熱温度と時間を確認できます。(単独使用可)

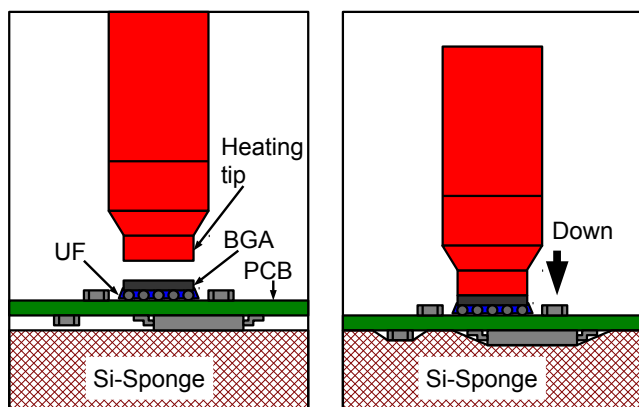
仕 様

- 適合 BGA : 7mm×7mm～20mm×20mm
- 適合基板 : 標準ワークホルダー : 30×30mm～170×105mm t : 0.4～1.2mm
オプションホルダー : 50×50mm～220×160mm t : 0.4～1.6mm
- 加熱温度 : 加熱バー : 300～440℃ (加熱チップ : 280～420℃) PID 制御
- 加熱時間 : Auto : 0.1～999.9 秒 (タイマー)
Manual : START - RESET (任意)
- 加熱チップ : アルミニウム(5052) + 二酸化モリブデンコート(硬質潤滑コート)
標準付属品(3 個) : ①7mm×7mm、② 12mm×12mm、③ 18mm×18mm
オプションチップ : 8mm×8mm、10mm×10mm、15mm×15mm、
20mm×20mm、その他特注。
- チップ接触圧力 : 約 300g 圧力調整 : +5 段 -2 段
加熱チップの高さ : +2.5mm(5 段) / -1.0mm(2 段), 0.5mm step
- 位置合わせ : DOWN : 加熱チップを BGA の上数ミリまで下げて、BGA と合わせる。
- ワークホルダー : 標準付属ホルダー : (W)200×(D)125×(H)21mm 600g
オプションホルダー : (W)240×(D)180×(H)21mm 1050g
基板サポーター : シリコンスポンジ t : 8mm / 10mm (付属、消耗品)
位置決め : X - Y フリー
固定 : 電磁ロック
- 温度プロファイルチェッカー : 3ch、ソフトウェア付属。(PC は別)。単独使用できます。
- 電源 : AC100V 270W / AC220V 270W
- 外形寸法・重量 : (W)260×(D)370×(H)360mm、約 13kg

用 途

- スマートフォン、カーナビやタブレット PC の基板修理における、BGA のリペアー。
- アンダーフィル剤を塗布した BGA の基板からの取り外し。

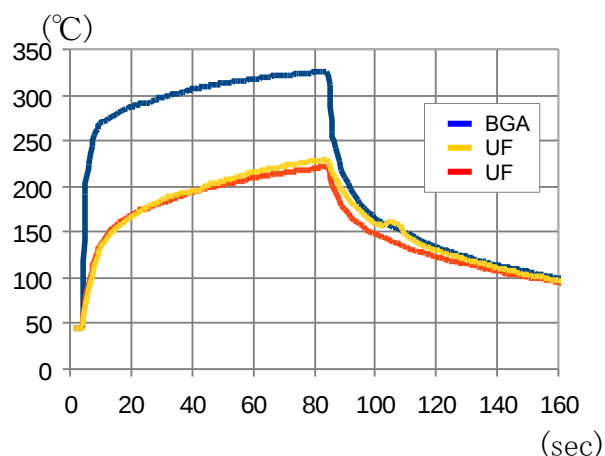
加熱方法



ポジショニング

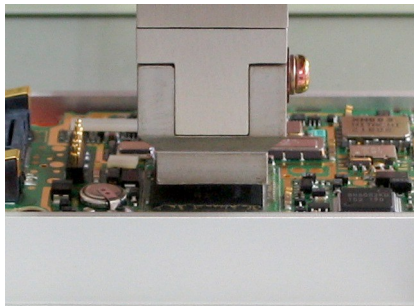
加熱

温度プロファイル

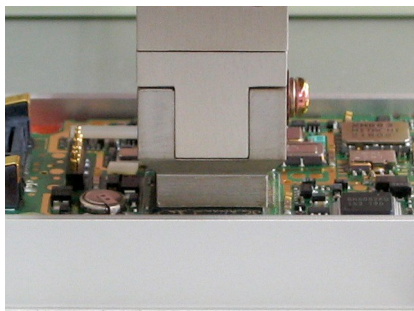


作業手順

- ① BGA と同サイズの加熱チップをセットする。
- ② PCB をワークホルダーにセットする。
- ③ **DOWN** 加熱バーをポジショニング位置へ下げる。
- ④ ワークホルダーをずらして、BGA と加熱チップの位置を合わせ **LOCK** する。

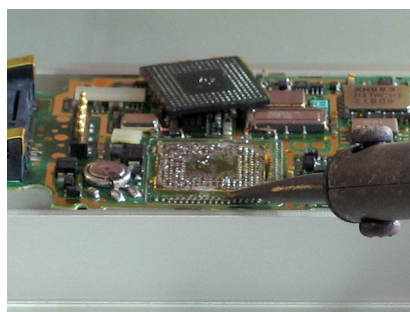
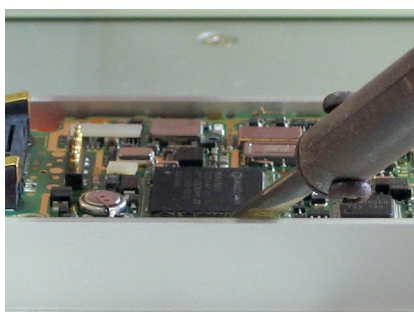


- ⑤ 加熱温度 (300～440℃) と時間 (20～80 秒) をセットする。(温度プロファイルを測定する。)
- ⑥ **AUTO** **START** 加熱バーが降りて、BGA を上部より直接加熱する。



- ⑦ タイムアップしてブザーが鳴り、加熱バーが上がったら、ナイフ形ヘラ(加熱ヘラ)で BGA を除去する。

MANUAL の時は **RESET** で加熱バーが上昇する。



動 画

弊社 Web からご覧下さい。 <http://www.jpl.co.jp/products/smt/asx/BR-515.asx>

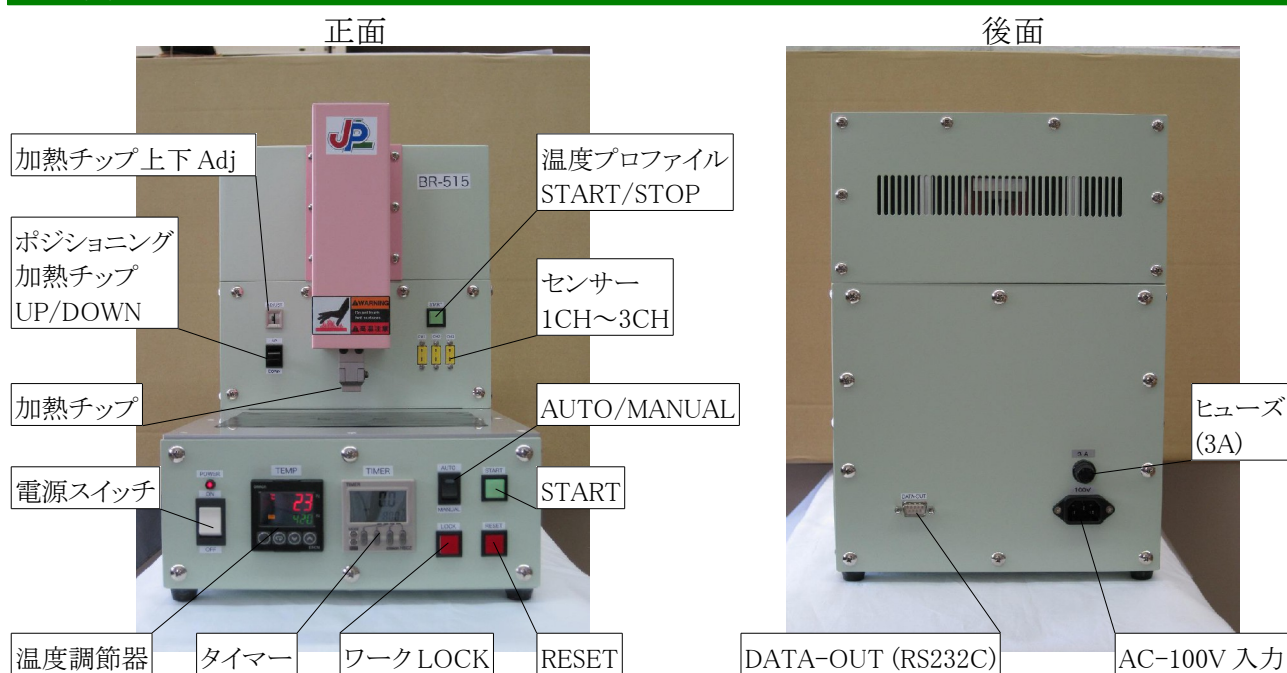
付属品

① 本体	1 台
② 加熱チップ 7mm× 7mm	1 個
③ " 12mm× 12mm	1 個
④ " 18mm× 18mm	1 個
⑤ ワークホルダー小(スポンジ付)	1 個
⑥ センサー K 0.127mm Φ	3 本
⑦ カプトンテープ	1 巻
⑧ USB (232C 変換) ケーブル	1 本
⑨ 電源コード (3P プラグ)	1 本

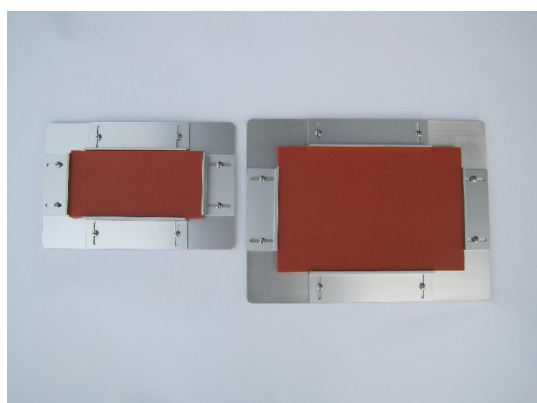
オプション部品

① 加熱チップ 8mm× 8mm	
② " 10mm× 10mm	
③ " 15mm× 15mm	
④ " 20mm× 20mm	
⑤ " 特注サイズ	
⑥ ワークホルダー大(スポンジ付)	
⑦ シリコンスポンジ 130mm× 65mm	8t/10t/12t
⑧ " 180mm× 120mm	8t/10t/12t

各部名称

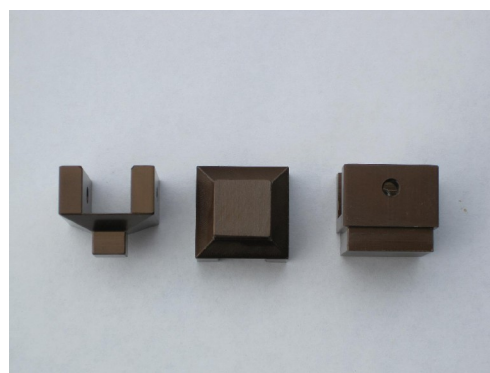


ワークホルダー



小(標準品) 大(オプション)

加熱チップ



7×7mm 12×12mm 18×18mm

※本仕様は予告なく変更する事があります。